

无压熔渗制备高体积分数SiCp/Al复合材料及其性能研究



作者：王庆平，吴玉程著

出版社：合肥：合肥工业大学出版社，2012. 04

总页数：115

说明：登录教客网（<https://www.jiaokey.com/book/detail/13145213.html>）查找全本阅读方式

无压熔渗制备高体积分数SiCp/Al复合材料及其性能研究 评论地址：

<https://www.jiaokey.com/book/detail/13145213.html>

教客网提供千万本图书阅读地址。

<https://www.jiaokey.com/book/detail/13145213.html>

书名：无压熔渗制备高体积分数SiCp/Al复合材料及其性能研究